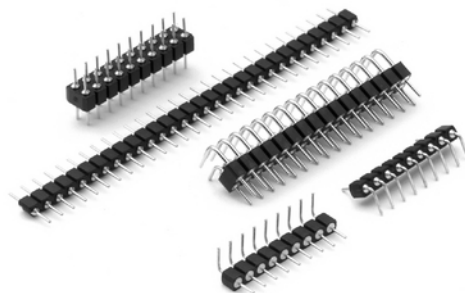


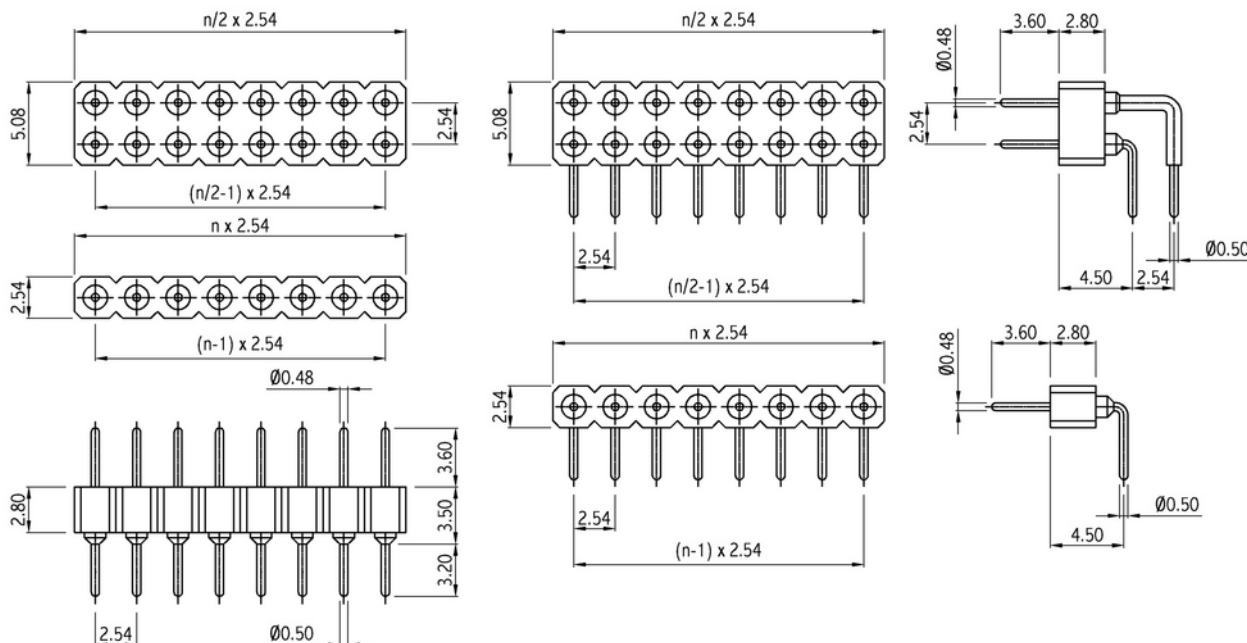
Adapter-Leisten RM 2,54mm, gerade/gewinkelt - Spezialkontakte 0,48/0,50mm Adapter Headers, 2.54mm Pitch, Straight/Right-Angled - 0.48/0.50mm Contacts

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Messing gedreht
Contact Material	Screw machined brass
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (2 ... 3µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (2 ... 3µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV _{RMS}
Test Voltage	1kV _{RMS}
Nennspannung	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Voltage Rating	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering



© W+P PRODUCTS



Series

164

Contacts*

02

01-64 Einreihig
Single row
02-64 Zweireihig
Double row

Terminal*

11

10 Einreihig, gerade
Single row, straight
20 Zweireihig, gerade
Double row, straight
11 Einreihig, gewinkelt
Single row, right angled
21 Zweireihig, gewinkelt
Double row, right angled

Plating*

10

00 Vergoldet
Gold plated
10 Vergoldet 0,25µm
0.25µm gold plated
50 Zinn 5,0µm
5.0µm tin plated

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

